



行业动态
Industry News



华虹NEC展示五大特色工艺平台

2010-11-22 | 编辑: | [【大】](#) [【中】](#) [【小】](#) [【打印】](#) [【关闭】](#)

核心提示：华虹NEC在IC China 2010展示了嵌入式非挥发性存储器、模拟/电源管理芯片、高压、射频和功率器件等五大特色工艺平台的最新技术和解决方案。

第八届中国国际半导体博览会暨高峰论坛（IC China 2010）于2010年10月21~23日在苏州国际博览中心举办。本届盛会以“合作创新、整合优化、持续发展”为主题，不仅汇聚了中国半导体产业发展的重大成果，而且展望了下一个五年产业发展的宏伟蓝图。

世界领先的纯晶圆代工厂之一，上海华虹NEC电子有限公司（以下简称“华虹NEC”）精彩亮相IC China 2010，展示了其嵌入式非挥发性存储器、模拟/电源管理芯片、高压、射频和功率器件等五大特色工艺平台的最新技术和解决方案。新颖别致的展台、丰富多样的展品吸引了众多参观者驻足观看。中国半导体行业协会名誉理事长俞忠钰先生、执行副理事长徐小田先生等领导也亲临华虹NEC展台参观，对公司的新产品和新技术表现出了浓厚的兴趣。

IC China 2010的高峰论坛和专题技术研讨会也在展会期间同期举办，对全球半导体产业发展、最新技术、IC产品设计以及绿色节能等热点问题进行了探讨和交流。华虹NEC市场副总裁高峰先生应邀在中国半导体装备、材料与制造工艺专题研讨会上发表了题为“新兴热点应用的代工解决方案”的精彩演讲，并向与会专家和领导汇报了公司承担的两个国家科技重大专项（02专项）的进展情况及阶段性成果。他说：“华虹NEC正在开发世界先进的高密度0.18微米 Bipolar-CMOS-DMOS(BCD180)技术和0.18/0.13微米 SiGe-BiCMOS技术，以期实现高端电源管理芯片和无线射频芯片的国产化。目前这两个02专项项目进展顺利，我们正在为将来的量产做准备。华虹NEC将不断增强自主创新能力，以更先进的技术和更优质的服务，与客户共同迎接半导体产业的新一轮发展！”

此外，公司在展会期间还举行了“工艺技术平台发展路线图”现场发布会，与众多与会嘉宾共同分享了华虹NEC的最新技术路线图和发展规划。

（来源：半导体国际 2010年11月5日）

- ▣ [科普首页](#)
- ▣ [微电子历史](#)
- ▣ [行业动态](#)
- ▣ [术语解释](#)
- ▣ [无微不至](#)
- ▣ [芯片制程](#)
- ▣ [科普创意](#)



中国科学院微电子研究所版权所有 邮编：100029

单位地址：北京市朝阳区北土城西路3号，电子邮件：webadmin@ime.ac.cn

京公网安备110402500036号